

Wide Bandgap für die 5G-Infrastruktur

650-V-CoolSiC in modernen Telekommunikations-SMPS

19. Oktober 2021, 12:15 Uhr | Von Francesco Di Domenico, Lead Principal Application Engineering bei Infineon - Technologies

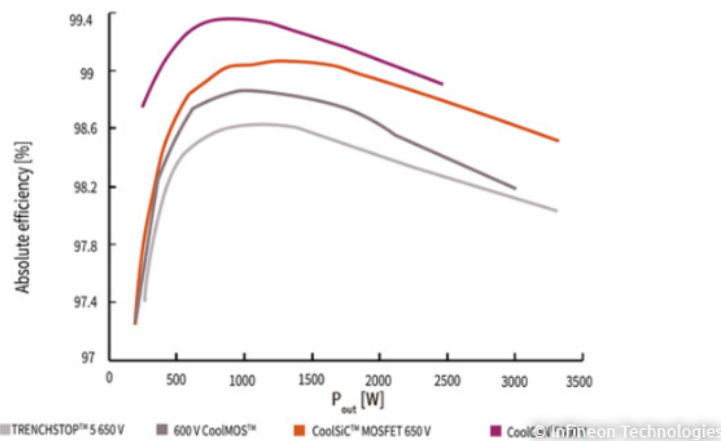


Bild 1: Die gemessenen Wirkungsgrade für verschiedene Gerätetechnologien

Im Zuge des Aufbaus der 5G-Infrastruktur profitieren Telekommunikationsumrichter-Anwendungen der neuesten Generation erheblich von den Eigenschaften und der Leistung der CoolSiC-Technologie. Sie ermöglicht die Realisierung äußerst zuverlässiger, robuster und effizienter Designs.

elektroniknet.de

Click [here](#) to read the full article:

650-V-CoolSiC in modernen Telekommunikations-SMPS

Authored by:
Francesco Di Domenico, Lead Principal Application Engineering,
Infineon Technologies